

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	详见附件《参会人员名单》
时间	2024年4月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生；副总经理、财务总监金良凯先生； 副总经理、董事会秘书李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司今年 Q1 营收增速强势，请帮忙分析下游客户结构及对各领域景气度的后续展望？</p> <p>整体来看，由于集成电路行业的整体应用领域，公司营收主要来自消费电子/工规/车规等领域。具体来看，IoT 类客户占比 50%左右，PA 类占比 20%左右，安防领域占比 10%~15%，运算领域客户和汽车电子领域的营收绝对占比较低，但增速较快。</p> <p>公司主要客户以各细分领域的龙头设计公司为主，在所处领域具备较强的竞争力，公司期待客户的成长进一步带动公司的持续增长。</p> <p>2. 2024 年 Q1 的强劲增长归功于什么因素？截至目前为止，公司的稼动率维持在什么水平？</p> <p>公司 Q1 的营收增长是主要是由于原客户所处领域的景气度回升、新客户的拓展以及部分新产品线开始贡献营收。</p>

目前公司整体稼动率较为良好。

3. 公司台系客户拓展进度？公司面对台系客户的优势是什么？

公司台系大客户进展顺利，正在积极推进中。

公司客户结构优良，在多个领域展现出良好的竞争力。同时，客户基于多种考虑在寻求供应链本土化，公司在发展的过程中与台湾地区的头部客户也存在业务合作。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司无论在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。

4. 公司去年主要资本开支集中在什么地方？今年的资本开支计划是什么样的？

去年公司主要投资于厂房和设备，应用于 Pamid 模组、FC、CP、Bumping 领域。今年预计资本开支在 25 个亿左右。

5. 公司目前 Bumping 类产能？

目前 Bumping 产能在 3 万片左右，正在产能爬坡过程中。

6. 公司 2023 年折旧摊销情况？未来折旧趋势展望？公司营收达到什么水平可以覆盖折旧？

根据公司 2023 年的财报，公司全年折旧及摊销在 5.3 亿左右，随着未来公司在建工程逐步转固，公司的折旧绝对规模会逐步增长。公司营收规模持续保持快速增长，随着规模效应的逐渐显现，预计会对整体盈利水平呈现正面影响。

7. 今年的股权激励费用？后续还有没有股权激励计划？

公司 2023 年的股权激励费用在 3000 万左右，未来公司会根据自身发展需要适时推出相关计划，请关注公司届时的发布的公告。

8. 公司一季度毛利提升的原因？

从财务角度看，影响毛利率的核心因素有两个，一个是

	<p>稼动率，另一个是价格，Q1 稼动率处于较高水平，从目前来看，价格处于相对稳定的状态。随着公司 2024 年 Q1 的营收规模进一步扩大，以及一些新产品的导入和产品结构的变化，对于毛利率来说会形成正向的影响。</p> <p>9. 公司 2.5D 封装的布局及竞争优势？</p> <p>公司正在积极布局先进封装相关领域，通过实施 Bumping 项目掌握的 RDL 及凸点加工能力，为公司后续开展晶圆级封装、扇出式封装及 2.5D/3D 封装奠定了工艺基础。公司为此专门储备了相关团队；后续会视情况和需要出台相关激励措施。</p> <p>10. 公司车规领域客户拓展进度？</p> <p>公司重点发展车规、工规产品线，在汽车电子领域的产品在智能座舱、车载 MCU、图像处理芯片等多个领域通过了终端车厂及 Tier 1 厂商的认证。因为车规工规的品质要求也会相对严格，整体的认证的周期也较长，需要公司持续的进行精耕细作，目前整体收入占比相对较低。</p> <p>11. 公司目前的研发费用情况？</p> <p>公司高度重视研发投入，目前研发费用占比超过了 6%，在同行业中处于较高水平。</p> <p>风险提示：本次业绩说明会中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	《参会人员名单》
日期	2024 年 4 月 19 日